

低温焼結 Agナノペースト

Ag Nano-Paste for Low-Temperature Sintering

低温実装と鉛フリー高温はんだ代替に利用

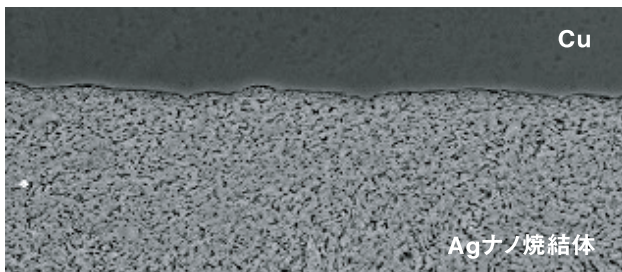
Used for low-temperature mounting and as a lead-free alternative to high-temperature solder

特長

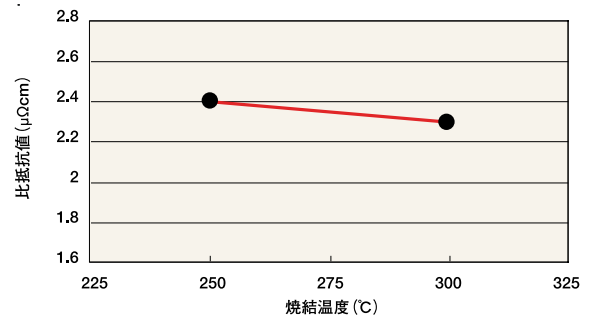
- 200～250℃の低温で実装可能、耐熱温度の低い太陽光セル実装に最適。
- 動作温度が高いパワーモジュールやLED実装に最適。
- 微細化で150～160℃実装に期待。低温加熱でオーミックなコンタクトを可能に。

製品仕様

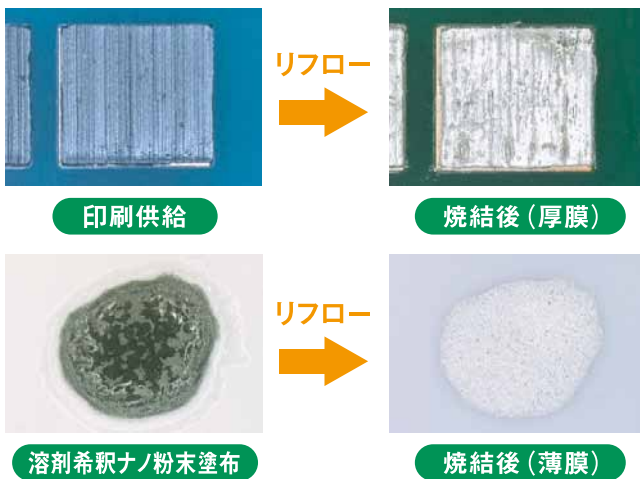
□ Agナノ焼結体の断面写真



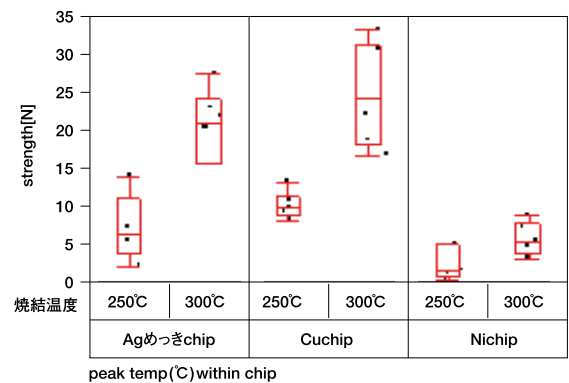
□ 焼結体 比抵抗値



□ 塗布形態(粉末量)による膜厚調整



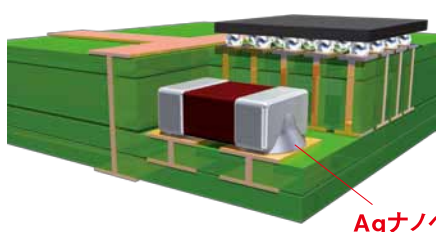
□ 接合強度評価



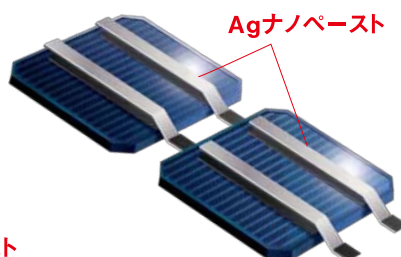
■ 試験基板
セラミック焼成基板 : Agランド3×3mm□パターン
チップ表面材質 : Ag, Cu, Ni
チップサイズ : 3×3mm□パターン

用途

□ 3D実装の内部接続用として



□ 太陽光セル実装用に



□ デバイスのダイボンディングに

